

狭隣接実装基板

特徴

- ・0201の実装技術を確立。パターン設計、基板、実装のソリューションを提供
- ・0402実装の部品間ピッチ0.15mmまでの狭隣接実装技術を確立
- ・BGA-BGA間ピッチ0.10mmまでの実装技術を提供

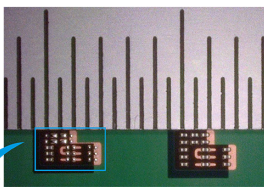
用途

- ・モバイル端末
- ・PC周辺機器
- ・業務用無線機
- ・車載機器
- ・各種センサ基板

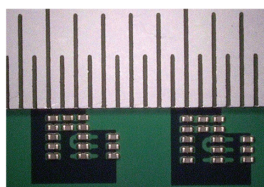
構造・仕様

昨今、高密度実装化が加速し、BGAの0.3mmピッチ等を筆頭に電子部品の微細化がさらに加速している。プリント配線板においては、ビルドアップ基板の多層化が進み、電子部品のパッドに対するフィレットレス化も身近になってきた。0402チップが主流になりつつある現在、更なるダウンサイジングのニーズは限定的とみられるが、次世代に向け、0201チップの実装技術、および0402チップの狭隣接実装を確立する。

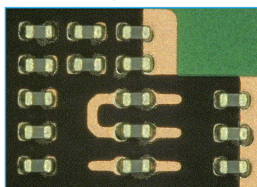
実装例(チップ)



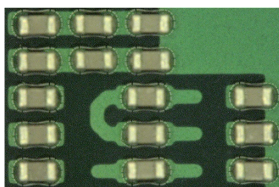
0201チップ部品間隔:0.15mm



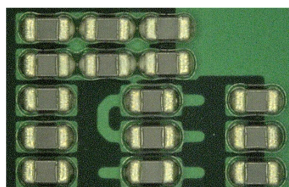
0402チップ部品間隔:0.15mm



0201チップ

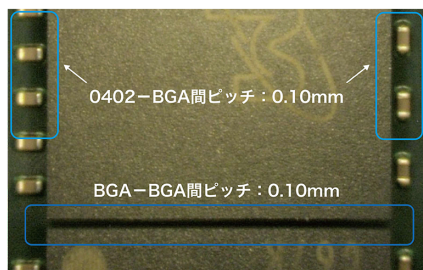


0402チップ



0603チップ

実装例(BGA)



狭隣接実装要素

